

中信建投证券股份有限公司
关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：厦门恒坤新材料科技股份有限公司
保荐代表人姓名：吴建航	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号北塔 2203 室
保荐代表人姓名：刘劭谦	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号北塔 2203 室

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2025〕2008 号文”批准，厦门恒坤新材料科技股份有限公司（简称“公司”或“恒坤新材”）向社会公开发行人民币普通股 6,739.7940 万股。公司本次发行新股的发行价为 14.99 元/股，募集资金总额为 101,029.51 万元，扣除发行费用 11,856.05 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 89,173.46 万元。本次公开发行股票于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”、“保荐人”）担任本次公开发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	保荐机构、保荐代表人应当协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和本规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。	保荐人已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
2	保荐机构、保荐代表人应当持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 保荐机构、保荐代表人应当对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。	保荐人已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 保荐人已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。

序号	工作内容	持续督导情况
	保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐人已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。
3	上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、本规则以及本所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。 上市公司及其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
4	保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐人已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
5	保荐机构、保荐代表人应当持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。 保荐机构、保荐代表人应当核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，保荐机构、保荐代表人应当发表意见予以说明。	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、查阅相关公开信息进行尽职调查等方式，了解公司经营、股票交易等情况，对公司开展持续督导工作。经核查，本持续督导期内，上市公司不存在持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项。
6	上市公司股票交易出现严重异常波动的，保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司及时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行信息披露义务。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
7	保荐机构、保荐代表人应当督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐人已督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
8	保荐机构、保荐代表人应当关注上市公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。	保荐人对上市公司募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并对上市公司募集资金存放、管理与实际使用情况进行了现场检查。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现恒坤新材存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

集成电路行业属于资金密集型行业，对半导体材料企业而言，生产基地建设与技术研发均需要持续、大规模的资金投入，具有高投入、高门槛、回报周期较长的行业特征，相应也伴随较高的经营与资金风险。

为保持市场核心竞争力，公司需持续投入研发、推进产能建设与产线升级，并通过吸引和保留优质人才、丰富产品结构以满足下游客户多样化需求，上述经营活动均对公司资金规模、资金使用效率及持续融资能力提出较高要求。若未来公司研发投入、产能扩张及市场拓展所需资金超出预期，或外部融资环境、融资渠道未能及时匹配公司发展需求，可能使公司面临阶段性资金压力，进而对业务发展、研发进度及整体经营业绩产生一定影响。

（二）经营风险

1、客户集中度较高及单一客户依赖的风险

报告期内，公司前五大客户（同一控制下合并计算）的收入占主营业务收入的比例为 94.37%，客户集中度较高。其中，向第一大客户的销售占主营业务收入的比例为 49.85%，对其存在较大依赖。鉴于公司产品目前主要应用于集成电路领域，下游客户主要系晶圆厂，行业集中度较高，公司预计在未来一定时期内仍将存在客户集中度较高的情形。若未来公司与重要客户的长期合作关系发生变化或终止，或主要客户因其自身经营原因而减少对公司产品的采购，或因公司在产品质量、技术创新和产品开发、生产交货等方面无法满足客户需求而导致与客户的关系发生不利变化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

2、核心技术泄密及核心技术人员流失风险

公司作为技术密集型企业，持续加大研发投入，不断壮大研发队伍建设，拥

有深耕半导体材料领域的资深研发与管理团队，积累多项知识产权与核心非专利技术，是实现技术迭代与产品国产化的关键核心资源。若公司出现管理不善或激励机制不到位等情况，可能导致核心技术人员的流失，进而造成核心技术泄密，影响公司的持续研发能力。

公司将通过完善激励机制、搭建多元职业发展通道，为核心技术人员提供良好的成长平台，充分调动技术人员积极性与归属感；同时建立健全知识产权管理、技术保密管理制度，多维度防范核心技术泄密风险。

3、贸易摩擦影响原材料与设备供应的风险

报告期内，公司自产产品所需的主要原材料、生产及检测设备或设备核心组件仍需通过进口，受国际贸易形势的影响较大。虽然公司已通过技术转让和自主研发相结合方式，致力将光刻材料核心原材料树脂实现国产化应用落地，降低原材料供应链的潜在风险，但是，受国际政治经济不确定性增强、国际贸易保护主义抬头等因素影响，将可能导致关键原材料和设备供应紧张甚至断供，进而对公司的技术升级及产品交付能力造成不利影响。

4、安全生产与环境保护的风险

公司生产产品系集成电路关键材料，生产工序、生产设备、生产人员较多，管理难度较大。公司生产过程产生的污染物包括废气、废水和固废等，可能会对周围环境产生一定影响。随着监管政策的趋严、公司业务规模的扩张，安全与环境保护的难度相应增大，可能会产生因操作不当、设备故障、不可抗力等因素导致的安全、环保事故，进而可能遭到有关政府部门的责令整改、处罚、停产，影响公司的正常生产经营。

（三）财务风险

1、汇率波动的风险

报告期内，公司引进光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他产品以及自产产品的原材料主要采购自韩国、日本等国家或地区，主要采用美元结算。报告期内，公司汇兑净损失的金额为 678.62 万元，占利润总额的比例为 7.52%。由于我国汇率市场化进程速度加快，加之受贸易摩擦、全球经济形势的影响，不排除未

来汇率出现较大波动的可能性，进而对公司业绩带来一定的影响。

2、政府补助减少的风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额为 1,120.80 万元，占公司当期利润总额比例为 12.42%。若未来政府补助政策发生变化，或公司未能满足相关要求导致无法取得政府补助或获得的政府补助减少，可能对公司的利润水平产生一定程度的不利影响。

（四）行业风险

1、宏观经济和行业周期波动的风险

集成电路行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，公司主营业务处于集成电路产业链前端的材料行业，其市场需求和全球及国内集成电路行业的发展状况息息相关，业务发展会受到集成电路行业周期性波动的影响。受国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧及供需关系变动的影响，公司下游客户需求将存在一定的波动性，进而影响公司的盈利水平。

2、市场竞争加剧的风险

公司定位为专注于集成电路关键材料产业化应用，以 12 英寸集成电路晶圆制造所需光刻材料与前驱体材料国产化应用为主要突破方向。公司的主要竞争对手既包括以美国、日本关键材料厂商为主的境外厂商，这类企业具有先发优势，长期处于垄断地位；也包括境内上市公司，其凭借良好背景、持续投入以及技术积累也已在光刻材料与前驱体材料取得一定突破。公司所处行业市场竞争将日趋激烈，如果公司不能保证产品质量，或无法持续提升技术水平、工业化生产能力、及时供应能力和成本管控能力，则公司可能无法有效应对激烈的市场竞争，进而对公司的竞争地位以及经营业绩产生不利影响。

（五）宏观环境风险

全球宏观经济形势及下游行业周期性波动，可能对市场需求及公司经营业绩产生一定影响。国内外经济政策、产业政策的调整变化，亦可能给公司生产经营和业务发展带来不确定性。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，恒坤新材不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	341,381,137.61	294,337,252.67	15.98
归属于上市公司股东的净利润	84,080,210.24	41,600,402.35	102.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,334,963.97	30,739,731.93	47.48
经营活动产生的现金流量净额	23,280,792.76	191,282,998.11	-87.83
主要会计数据	2026 年 6 月末	2025 年 12 月末	本期末比上年度末增 减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,586,061,093.14	2,504,272,921.05	3.27
总资产	3,805,300,274.31	3,985,012,430.20	-4.51

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.1871	0.1089	71.81
稀释每股收益（元/股）	0.1839	0.1082	69.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1009	0.0805	25.34
加权平均净资产收益率（%）	3.30	2.73	增加 0.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.78	2.02	-0.24
研发投入占营业收入的比例（%）	17.90	14.13	3.77

2026 年 1-6 月，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、报告期内，公司实现营业收入 34,138.11 万元，较去年同期增长 15.98%，

其中光刻材料同比增长 10.90%，前驱体材料同比增长 47.95%。公司近年来自产产品收入保持较快增长，业务规模持续扩大。

公司营业收入增长主要系公司持续聚焦半导体材料主业，不断深化在光刻材料、前驱体材料等核心产品领域的技术布局与工艺优化，自主研发与产品迭代能力持续提升。同时，公司积极拓展境内晶圆制造及先进封装客户，稳步推进重点产品线的客户验证与批量供货，拓展成效逐步显现。此外，公司紧密贴合下游客户产能释放与产品升级节奏，强化供应链保障与客户服务能力，核心产品出货量稳步提升，带动主营业务收入实现持续增长。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,533.50 万元，较去年同期增长 47.48%，主要系由于自产产品产销增长，盈利能力提升。

3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 8,408.02 万元，较去年同期增长 102.11%，除归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的变动影响以外，主要系由于持有的其他非流动金融资产、交易性金融资产等公允价值变动收益增加。

4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,328.08 万元，较去年同期下降 87.83%，主要系由于收到的补助款减少。

六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）核心技术优势

公司根据境外集成电路先进制程的发展历程，从中国境内企业并未充分涉足的光刻材料如 SOC、BARC 等在先进制程广泛应用的产品切入，快速实现替代与量产供货，填补国内空白。在光刻材料方面，公司进一步向 i-Line 光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 浸没式光刻胶、SiARC、Top Coating 等产品延伸，其中 i-Line 光刻胶与 KrF 光刻胶已实现销售，ArF 浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售，SiARC、Top Coating 亦已取得客户小批量订单。在前驱体材料方面，公司自产 TEOS 已实现规模化销售，还同步布局了其他金属基、High-K 前驱体研发和产业

化，多款产品已进入客户验证阶段，部分新品已通过验证取得订单。截至报告期末，公司已取得专利授权 122 项，其中发明专利 53 项。公司已取得的相关专利均系与公司主营业务相关的知识产权储备，保障了公司在集成电路关键材料领域的核心技术优势。

（二）研发创新优势

公司坚持自主研发为主的创新发展路径，持续保持高研发投入强度。2026 年 1-6 月，研发投入 6,112.40 万元，占营业收入比重达 17.90%。公司全资子公司福建泓光和大连恒坤为高新技术企业，2024 年福建泓光被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。同时，公司持续承接国家各类重大专项，在前期承接国家 02 科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务并已完成验收基础上，陆续新增联合承接国家多部委重要攻关任务，通过行业领先的研发能力为中国境内集成电路实现全产业链自主可控提供关键支持。

公司持续深化与国内重点高校、国家级半导体科研院所、上下游龙头企业的合作，积极参与半导体关键材料行业课题攻关，共建新材料联合实验室，整合资源开展研发试验工作。现阶段公司已搭建起覆盖半导体原材料及成品的配方设计、工艺开发、产业化应用验证的一体化、智能化研发平台，打通新品研发全链条，有效缩短新材料从实验室研发到批量供货的落地周期。

（三）客户资源优势

公司客户系国内主流 12 英寸集成电路晶圆厂，对各类关键材料供应商的产品质量和供货能力十分重视，关键材料供应均需严格验证，且通常需经较长验证周期方可进入供货阶段。报告期内，公司产品已在多家中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂实现销售，积累了众多优质客户资源，确保公司在后续产品导入和验证过程中的先发优势。

（四）人才团队优势

人才是企业发展的核心内生驱动力。公司秉持引才、育才、留才一体化人才发展理念，经过多年发展，公司汇聚了一支高学历、高素质、富有开拓进取及创新意识的研发队伍，同时拥有具备深厚行业积累的生产技术、市场服务专业人才。

公司持续面向半导体材料领域引进各类高层次人才，核心技术团队中既有具备晶圆制造工艺从业背景的技术专家，也拥有材料学科背景的高端技术人才，团队在集成电路材料领域沉淀了丰富的实操经验与技术储备。公司持续完善人才激励机制，充分调动团队创新积极性，高素质人才梯队为公司稳固市场竞争优势提供坚实保障。

（五）地域产能优势

公司已构建厦门总部、漳州光刻材料基地、大连前驱体基地、合肥先进材料基地的全国化产业布局，各基地定位清晰、专业化分工明确，形成光刻材料、前驱体材料分域规模化生产格局。各生产基地邻近国内半导体产业集群，区位优势显著，便于贴近下游晶圆制造企业，有效降低物流成本并提升技术对接响应效率。

公司将按募投项目规划稳步推进各基地建设 with 产能释放，持续完善产品供给能力，进一步增强面向下游客户的供应保障水平，在服务下游客户的同时助力国内集成电路材料产业链配套建设。

七、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司持续进行研发投入，以保持公司的核心竞争力以及技术的领先性。2026 年 1-6 月，公司研发投入总额 6,112.40 万元，较上年同期增长 46.92%。主要基于公司业务发展及技术布局需要，包括：

1、持续推进核心产品迭代与高端化研发

公司围绕光刻材料和前驱体材料等核心业务，持续对光刻材料、前驱体材料以及其他超高纯电子化学品等产品进行配方开发、工艺优化、性能提升与客户验证。随着先进制程验证推进、产品矩阵进一步丰富，研发材料消耗、检测验证及试验费用相应增加，推动研发投入稳步增长。

2、研发设备投入与技术平台持续完善

为满足更高精度、更高稳定性的研发测试需求，公司适度新增及升级研发检测设备，相关折旧费用、设备运维及实验室运行费用有所上升，进一步支撑关键技术攻关与自主创新能力建设。

3、加强前瞻性技术布局与专利布局

结合行业技术发展趋势，公司开展前瞻性研究，并持续加强知识产权保护与专利布局。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币	
项目	金额
一、募集资金总额	101,029.51
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	11,856.05
二、募集资金净额	89,173.46
减：	
以前年度已使用金额	24,057.22
本年度使用金额	6,109.02
暂时补流金额	-
现金管理金额	53,650.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他	-
加：	
募集资金利息收入	137.06
其他	-
三、报告期期末募集资金余额	5,494.27

注1：数据如有尾差系四舍五入所致。

注2：募集资金专户2026年6月30日余额为5,579.78万元，与上表中募集资金余额差异85.51万元为公司以自有资金支付但尚未置换的发行费用。

公司 2026 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）持股情况

1、控股股东、实际控制人

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人易荣坤直接持有公司 74,562,908 股，持股比例为 16.59%。

2、董事、高级管理人员

截至 2026 年 6 月 30 日，公司董事、高级管理人员的持股情况如下：

序号	名称	任职	持股数量（股）	持股比例（%）
1	易荣坤	董事长、总经理	74,562,908	16.59
2	王廷通	职工董事、副总经理	3,540,000	0.79
3	肖楠	董事、副总经理	12,350,000	2.75
4	庄超颖	董事	-	-
5	黄兴李	独立董事	-	-
6	邹友思	独立董事	-	-
7	苏小榕	独立董事	-	-
8	陈颖峥	董事会秘书	800,000	0.18
9	陈志明	财务总监	400,000	0.09

注：本表中列示的董事和高级管理人员持股数量为直接持股数量。

截至报告期末，除上述持有公司股份外，易荣坤先生通过兆莅恒、厦门神剑、晟临芯、晟临坤、共赢 62 号员工资管计划间接持股；肖楠先生、王廷通先生通过共赢 62 号员工资管计划间接持股；陈志明先生通过厦门神剑、晟临芯、共赢 62 号员工资管计划间接持股。

（二）质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

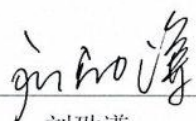
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



吴建航



刘劭谦

